

聚焦電子束系統注意事項

1. 目前接受委託代工 TEM 樣品，於上班時段(上午 8:00 至下午 6:00)，員工有優先使用權。
2. 每次使用須詳實填寫機台使用紀錄表，如有闕漏不實者，將視情節依規定議處。
3. 影像檔名與內容請自行牢記，中心不負記憶檔名與內容之責任；為活化硬碟空間，機台每年 2 月及 8 月進行影像曝光檔案清理，使用者請自負責任，不得異議。
4. 標準 TEM 樣品製備限定為矽晶片基材厚度不得超過 1 mm，收件樣品須小於 8 吋晶圓，須大於 5mmx5mm；完工 TEM 樣品厚度小於 100 nm，深度小於 5um，長度小於 15um。
5. 若送件樣品表面高低落差超過 1um，無法保證高低處同時可達到 100nm 厚度；若表面有絕緣層，建議先鍍好金屬層防止電荷累積效應；離子束會傷害樣品結晶性，無法保證無非晶化傷害
6. 非標準製程需求，須提出相關之書面說明，並經機台負責人核准，方可下線。